

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

露笑科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260522

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	草本投资、啟赋资本、羿鹏基金、领丰资本、九方智投、国元证券、华军证券、国金证券、固禾基金、康祺资产、昱奕资产
时间	2026年5月22日
地点	安徽省合肥市长丰县合肥露笑半导体材料有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李陈涛、合肥露笑总经理 胡阳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者问答</p> <p>问题 1：请介绍公司当前在行业中的市场地位，以及公司目前产品所具有的优势。</p> <p>回复：公司属于碳化硅行业上游材料端的上市公司，技术实力领先。公司已攻克 6/8/12 英寸碳化硅晶体生长、衬底精密加工等关键核心技术，实现 8 英寸碳化硅衬底稳定量产、12 英寸新品研发突破。</p> <p>具体优势如下：</p> <p>1、自研长晶技术，成本与良率领先：自主研发 PVT 法长晶工艺，6/8 英寸导电型衬底良率高于行业平均水平，单炉产出效率高，原材料与生产环节国产化率高。相比行业头部企业，产品具备一定性价比优势，在成本敏感型下游市场竞争力突</p>

投资者关系活动
主要内容介绍

出。

2、产能布局扎实，扩产潜力充足：布局专业化碳化硅生产基地，6/8 英寸衬底现有产能处于稳步爬坡阶段，远期规划产能规模可观，可满足下游客户批量采购需求，能够适配下游行业快速增长的市场需求。

3、大尺寸技术跟进迅速：已经成功研发 12 英寸衬底，具备冲击高端市场的技术潜力。

问题 2：公司如何看待 8 英寸和 6 英寸产品的未来发展趋势？一个 8 英寸碳化硅晶体可切割成多少衬底片？公司对于 8 英寸的产品未来有怎么样的布局和规划？

回复：自 2025 年起，市场开始逐步推进 8 英寸替代 6 英寸的进程。6 英寸产品不会消失，但市场份额会逐步被 8 英寸所替代。8 英寸面积是 6 英寸的 1.78 倍，客户在使用 8 英寸后会显著降低产品成本，进一步提升产品竞争力。目前，公司一个 8 英寸碳化硅晶体大致可切割出 35-45 片衬底。公司 2026 年起着力提升 8 英寸导电衬底与 8 英寸半绝缘衬底的良率、降低晶体缺陷与成本，后续将持续扩大 8 英寸产能建设，进一步提高在 8 英寸市场的占有率。

问题 3：请介绍公司目前碳化硅衬底总体产能以及产能规划。

回复：合肥露笑一期规划衬底总产能 24 万片/年，目前已建成达产 6 万片/年。公司初步计划于 2026 年下半年启动进一步扩产，逐步将产能提升至 12 万片/年；具体将根据市场需求实际情况实时调整相应产能规划。

问题 4：目前 6 英寸和 8 英寸衬底价格趋势情况如何？

回复：6 英寸衬底价格自 2025 年底起已快速触底回升，8

	<p>英寸衬底价格维持稳定并小幅升高，8 英寸衬底供不应求。</p> <p>问题 5：国内是否有成熟的碳化硅加工设备？设备采购后是否需要调试以匹配工艺？</p> <p>回复：近年来，国内涌现出多家优秀的碳化硅加工设备供应商，如大族激光、西湖仪器、特思迪、华林嘉业等。国产加工设备已较多应用在碳化硅行业，设备成熟度较高。公司加工工艺人员已熟练掌握设备并建立了基本工艺，设备采购到位后较短时间即可正式运行生产。</p> <p>问题 6：SiC 衬底在 SST 中成为重要的功率器件材料，公司如何看待 SiC 衬底在 SST 的相关应用？未来的需求判断是怎样的？</p> <p>回复：传统数据中心供电链路需要经过中压交流→工频变压器降压→低压交流→UPS 整流→直流→电池→逆变→交流→服务器电源整流→直流的多次交直流变换，整体效率仅约 90%—92%，且设备体积庞大、铜材用量高。</p> <p>固态变压器（SST）通过碳化硅（SiC）MOSFET 等高频功率器件与高频隔离变压器，实现中压交流→低压直流的一步转换，省去中间多重变换环节，转换效率可提升至 98.5%以上，体积缩减 60%以上，电力损耗降低 40%以上，铜材用量减少约 45%。</p> <p>机构预测，SST 赛道将于 2026 年开启商业化，市场规模将从约 100 亿元增长至 2030 年超千亿元。预计 2026 年底前，国内 TOP10 云厂商的新建智算中心将全部采用 SST+高压直流架构，渗透率达 30%以上。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 25 日

